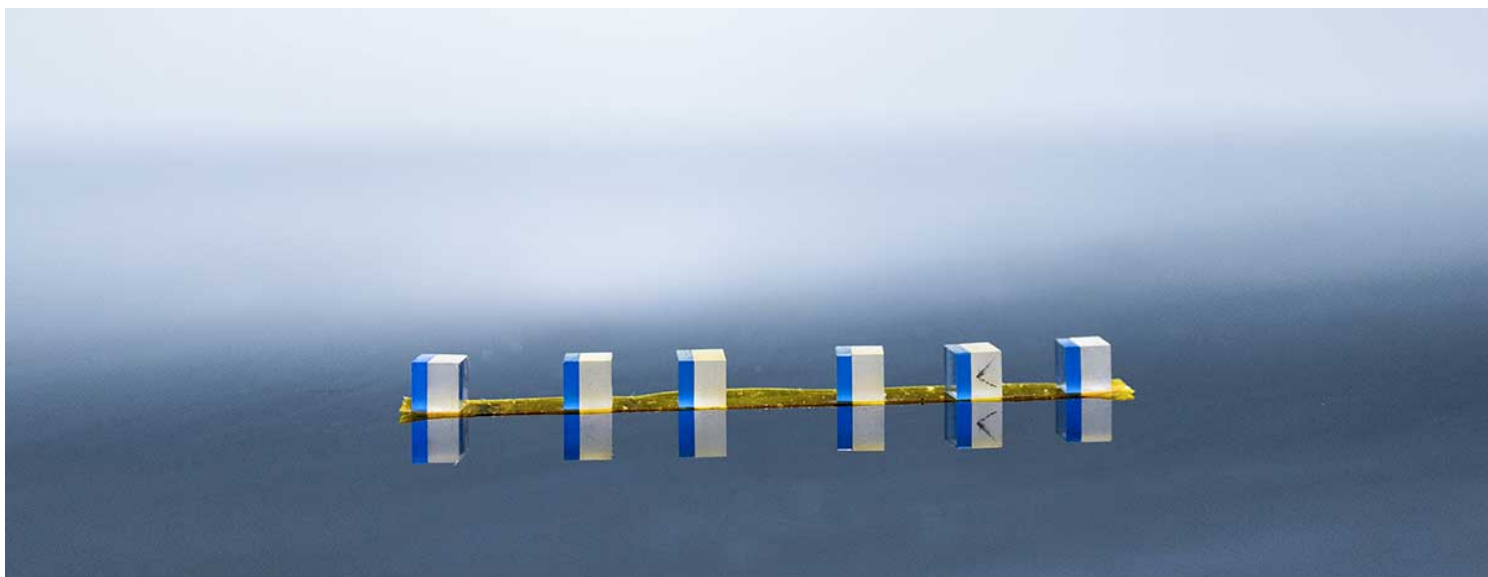


# Er,Yb:glass+Co:spinel



## 描述

我司Er,Yb:glass+Co:spinel键合晶体，是在Er,Yb:glass一端键合Co:spinel形成的键合晶体，可以有效的改善Er,Yb:glass激光的综合性能。

键合形成Er,Yb:glass+Co:spinel键合晶体，可以有效改善Er,Yb:glass晶体的热效应，降低激光泵浦时形成的热透镜效应，改善激光的光束质量，提升1535nm激光输出效率，并能提升激光器的输出能力稳定性，提升激光器的使用寿命。

上海芯飞睿使用表面活化键合技术，是一种低温或者常温下的键合技术，典型特征是表面清洗和表面活化。在键合前，通过快原子或者离子束对键合表面的轰击，可以有效的增加键合强度，实现对无机材料、金属、半导体材料间的高质量键合。与高温热键合方法相比，表面活化键合技术键合结合力界面较高、光吸收损耗和面形变化控制相对而言更优，而热扩散键合表面的杂质去不掉，被键合在结合面。表面活化键合技术有去除各种抛光的残留成分、去除有机污染物、去除表面氧化层和打断材料化学键，提升活化能等优点。

生产的Er,Yb:glass+Co:spinel键合晶体的键合强度高、键合面吸收损耗小（一般小于20ppm）、键合面面形变化小（键合后面形 $<\lambda/8$ ）。键合晶体的形状可以是棒状、板状、波导或者三明治形状。在键合晶体两端可以提供多种类型的镀膜，如两个端面增透膜AR@1535nm，或S1:HR@1535nm+AR@940nm，S2:AR@1535+HR@940nm，或S1:HR@1535nm+AR@940nm，S2:PR@1535+HR@940nm等。Er,Yb:glass+Co:spinel键合晶体广泛应用于测距仪，雷达，目标识别等领域广泛应用。

## 特点

- 可以有效改善Er,Yb:glass晶体的热效应
- 降低激光泵浦时形成的热透镜效应
- 改善激光的光束质量，提升1535nm激光输出效率
- 能提升激光器的输出能力稳定性，提升激光器的使用寿命

## 应用

- 测距仪
- 雷达
- 目标识别



# Er,Yb:glass+Co:spinel

## 参数

Er,Yb:glass+Co:spinel		
材料	Er,Yb:glass	Co:spinel
掺杂浓度	0.5%\1.0%\1.5%	/
初始折射率	/	30 ~ 99%
晶体结构	Rods/Slabs/Sandwich/Waveguide/	
端面配置	Flat/Convex/Wedge	
侧面配置	Polish/Fine Ground	
镀膜	AR@1535nm	AR@1535nm
	HR@1535nm+AR@940nm	AR@1535+HR@940nm
	HR@1535nm+AR@940nm	PR@1535+HR@940nm
	others	others



有什么问题请联系我们的  
技术工程师，在线为  
您解答



了解更多资讯，请关注  
我们的公众号--上海芯  
飞睿科技有限公司

